

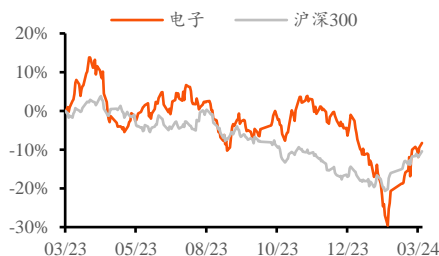


## AI 芯片 WSE-3 发布，三星产 HBM 获 AMD 验证通过 ——电子行业周报（2024.03.11-2024.03.15）

增持(维持)

行业： 电子  
日期： 2024年03月16日  
分析师： 陈宇哲  
E-mail: chenyzhe@yongxings.com  
SAC 编号: S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

相关报告:

《英伟达或将推出 B100，美光宣布量产 HBM3e》

——2024 年 03 月 04 日

《英伟达 FY24Q4 业绩亮眼，Groq 芯片搭载 SRAM》

——2024 年 02 月 26 日

《SK 海力士推进 HBM 扩产，Meta 自研 AI 芯片投产》

——2024 年 02 月 06 日

### 核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

**算力芯片:** AI 芯片 WSE-3 发布，峰值算力高达 125Pflops，算力芯片产业加速发展。Cerebras Systems 发布第三代晶圆级 AI 加速芯片“WSE-3”，其为台积电 5nm 工艺，晶体管数量达到 4 万亿个，AI 核心数量增加到 90 万个；峰值 AI 算力高达 125PFlops。我们认为，随着生成式人工智能不断涌现，加速计算需求旺盛，相关产业链有望持续受益。

**存储芯片:** 存储现货价格坚挺，市场整体仍保持复苏势头，存储芯片产业链景气有望复苏。部分原厂 wafer 报价继续强势上扬，受资源成本上涨影响，存储价格整体依然坚挺。我们认为，随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

**先进封装:** Silicon Box 计划投建先进封装产能，产业链有望持续受益。Silicon Box 宣布计划与意大利政府合作，在意大利北部投资 36 亿欧元，建设先进封装产能。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

**HBM:** 三星产 HBM 获 AMD 验证通过，产业链有望持续受益。2024 年第一季度，三星 HBM3 产品也陆续通过 AMD MI300 系列验证，其中包含其 8h 与 12h 产品，故自 2024 年第一季度以后，三星 HBM3 产品将会逐渐放量。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周 (3.11-3.15)，A 股申万电子指数上涨 0.76%，整体跑赢沪深 300 指数 0.05pct，跑输创业板综指数 3.78pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：其他电子 II(3.47%)、光学光电子(1.88%)、电子化学品 II(1.46%)、消费电子(0.43%)、半导体(0.34%)、元件(0.23%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(4.85%)、申万电子(0.76%)、道琼斯美国科技(-0.4%)、纳斯达克(-0.7%)、台湾电子(-1.6%)、费城半导体(-4.04%)。

### 投资建议

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链。

**人工智能:** 英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

**存储芯片:** 受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等；

**先进封装:** 受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

**HBM:** 受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等。

### 风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

## 正文目录

1. 本周核心观点及投资建议 .....	3
2. 市场回顾 .....	5
2.1. 板块表现 .....	5
2.1. 个股表现 .....	6
3. 行业新闻 .....	8
4. 公司动态 .....	10
5. 公司公告 .....	13
6. 风险提示 .....	14

## 图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (3.11-3.15) .....	5
图 2: .....	5
图 3: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (3.11-3.15) .....	5
图 4: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (3.11-3.15) .....	6
图 5: 海内外指数涨跌幅情况 (3.11-3.15) .....	6

## 表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (3.11-3.15) .....	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (3.11-3.15) .....	13

## 1. 本周核心观点及投资建议

### 核心观点:

**算力芯片:** AI 芯片 WSE-3 发布, 峰值算力高达 125Pflops, 算力芯片产业加速发展。根据科创板日报报道, 美国加州半导体公司 Cerebras Systems 发布第三代晶圆级 AI 加速芯片“WSE-3”, 其为台积电 5nm 工艺, 晶体管数量达到 4 万亿个, AI 核心数量增加到 90 万个, 缓存容量达到 44GB, 外部搭配内存容量可选 1.5TB、12TB、1200TB; 峰值 AI 算力高达 125PFlops。我们认为, 随着生成式人工智能不断涌现, 加速计算需求旺盛, 相关产业链有望持续受益。

**存储芯片:** 存储现货价格坚挺, 市场整体仍保持复苏势头, 存储芯片产业链景气有望复苏。根据 CFM 闪存市场报道, 在存储现货市场需求放缓的市况下, 本周存储行情多以持平为主, 市场观望氛围浓厚, 现货 SSD 和内存价格维持不变, 嵌入式需求较为稳固本周价格小幅上扬。部分原厂 wafer 报价继续强势上扬, 受资源成本上涨影响, 存储价格整体依然坚挺, 供需两端短期态度分化多空激烈博弈。我们认为, 随着下游需求或将持续好转, 存储芯片价格有望延续上涨, 相关产业链有望持续受益。

**先进封装:** Silicon Box 计划投建先进封装产能, 产业链有望持续受益。根据 IT 之家报道, 半导体创企 Silicon Box 宣布计划与意大利政府合作, 在意大利北部投资 36 亿欧元, 建设先进封装产能。我们认为, 先进封装在算力时代重要性逐步凸显, 相关产业链有望持续受益。

**HBM:** 三星产 HBM 获 AMD 验证通过, 产业链有望持续受益。根据 TrendForce 集邦咨询调查, 2024 年第一季度由 SK 海力士率先通过验证, 美光紧跟其后, 并于第一季底开始递交 HBM3e 量产产品, 以搭配计划在第二季末铺货的 NVIDIA H200。三星由于递交样品的时程较其他两家供应商略晚, 预计其 HBM3e 将于第一季末前通过验证, 并于第二季开始正式出货。由于三星是 AMD 长期以来最重要的策略供应伙伴, 2024 年第一季度, 三星 HBM3 产品也陆续通过 AMD MI300 系列验证, 其中包含其 8h 与 12h 产品, 故自 2024 年第一季度以后, 三星 HBM3 产品将会逐渐放量。我们认为, 各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产, 相关产业链有望持续受益。

### 投资建议:

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链。

**人工智能：**英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注**寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科**等；

**存储芯片：**受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐**东芯股份**，建议关注**恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技**等；

**先进封装：**受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注**甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子**等；

**HBM：**受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注**赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科**等。

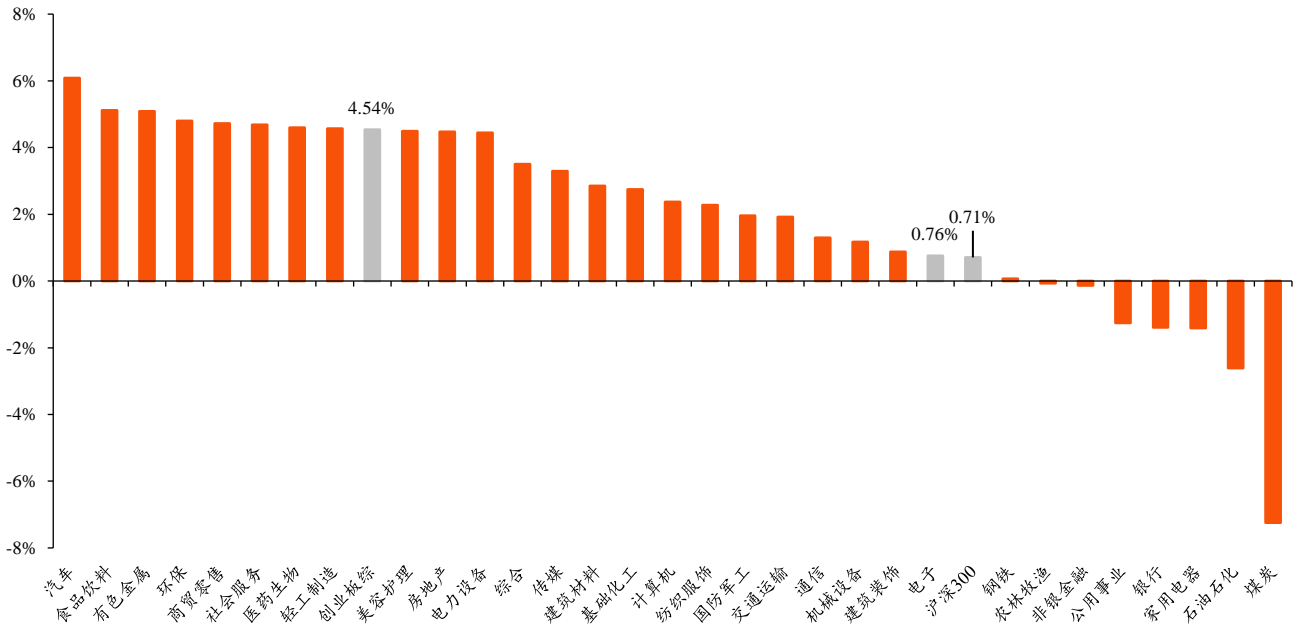
## 2. 市场回顾

### 2.1. 板块表现

本周（3.11-3.15），A股申万电子指数上涨0.76%，板块整体跑赢沪深300指数0.05pct，跑输创业板综指数3.78pct。在申万31个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第23位。

图1:A股申万一级行业涨跌幅情况(3.11-3.15)

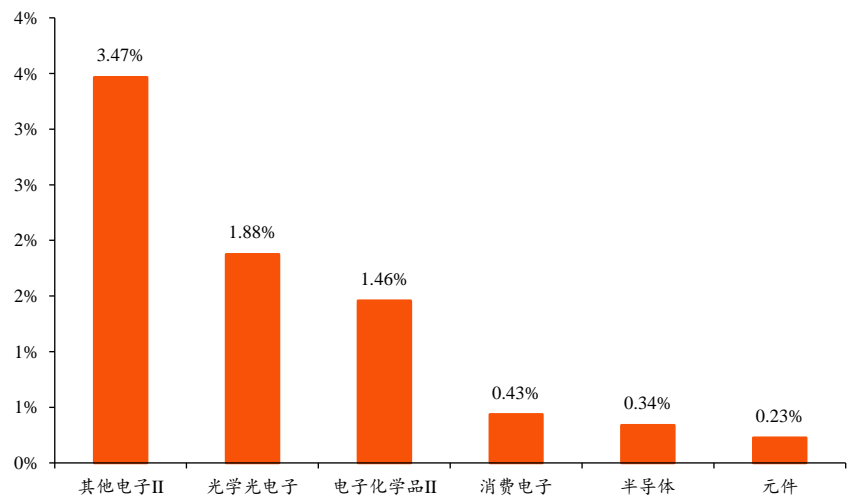
图2:



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（3.11-3.15）申万电子二级行业中，其他电子 II 板块上涨3.47%，表现较好；元件板块上涨0.23%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：其他电子II(3.47%)、光学光电子(1.88%)、电子化学品II(1.46%)、消费电子(0.43%)、半导体(0.34%)、元件(0.23%)。

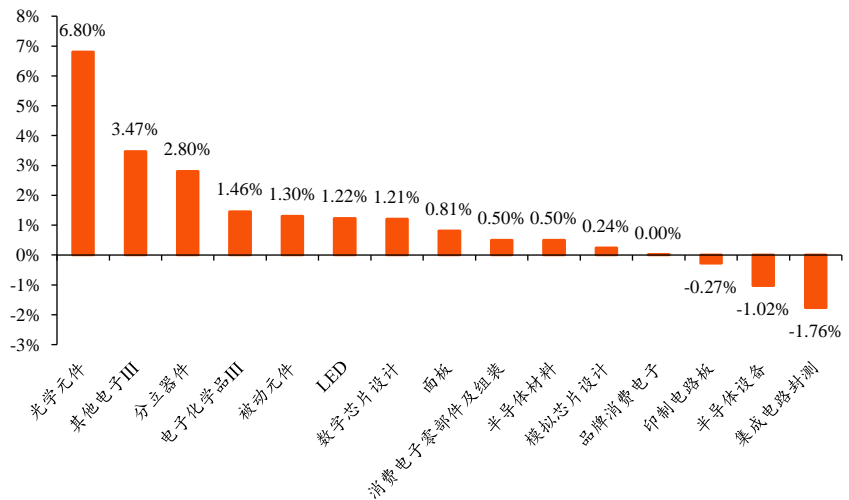
图3:A股申万二级行业涨跌幅情况(3.11-3.15)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（3.11-3.15）申万电子三级行业中，光学元件板块上涨 6.8%，表现较好；集成电路封测板块下跌 1.76%，表现较差。表现靠前的板块分别为：光学元件(6.8%)、其他电子III(3.47%)、分立器件(2.8%)。表现靠后的板块分别为：集成电路封测(-1.76%)、半导体设备(-1.02%)、印制电路板(-0.27%)。

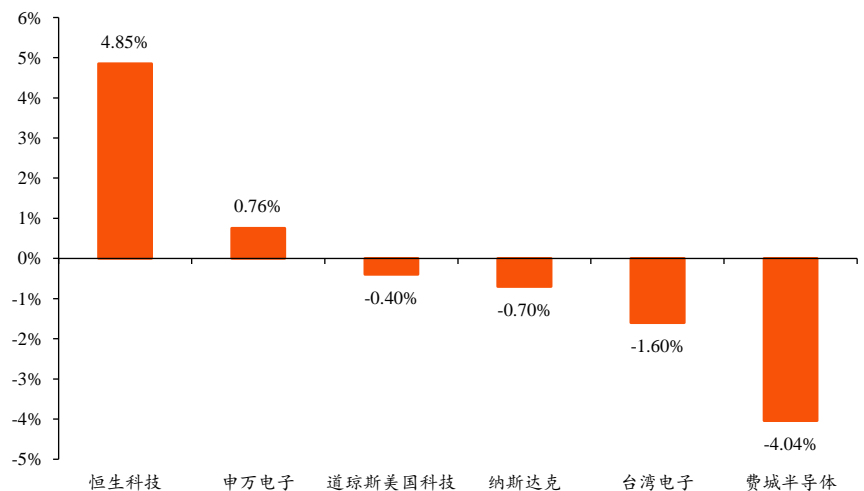
图4:A股申万三级行业涨跌幅情况（3.11-3.15）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势。本周（3.11-3.15），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(4.85%)、申万电子(0.76%)、道琼斯美国科技(-0.4%)、纳斯达克(-0.7%)、台湾电子(-1.6%)、费城半导体(-4.04%)。

图5:海内外指数涨跌幅情况（3.11-3.15）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

## 2.1. 个股表现

本周(3.11-3.15)个股涨跌幅前十位分别为:东田微(+38.93%)、昀冢科技(+34.6%)、裕太微(+31.12%)、商络电子(+28.4%)、福日电子(+25.58%)、瑞德智能(+19.58%)、力源信息(+19.51%)、奥比中光(+16.37%)、沃格光电(+16.16%)、鸿日达(+15.56%)。个股涨跌幅后十位分别为:好上好(-9.97%)、智动力(-8.79%)、泓禧科技(-7.3%)、工业富联(-7.2%)、生益电子(-6.88%)、睿能科技(-6.69%)、亿道信息(-6.31%)、世运电路(-5.84%)、合力泰(-5.8%)、希荻微(-5.74%)。

**表1:电子行业(申万)个股本周涨跌幅前后10名(3.11-3.15)**

周涨跌幅前10名			周涨跌幅后10名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
301183.SZ	东田微	38.93%	001298.SZ	好上好	-9.97%
688260.SH	昀冢科技	34.60%	300686.SZ	智动力	-8.79%
688515.SH	裕太微	31.12%	871857.BJ	泓禧科技	-7.30%
300975.SZ	商络电子	28.40%	601138.SH	工业富联	-7.20%
600203.SH	福日电子	25.58%	688183.SH	生益电子	-6.88%
301135.SZ	瑞德智能	19.58%	603933.SH	睿能科技	-6.69%
300184.SZ	力源信息	19.51%	001314.SZ	亿道信息	-6.31%
688322.SH	奥比中光	16.37%	603920.SH	世运电路	-5.84%
603773.SH	沃格光电	16.16%	002217.SZ	合力泰	-5.80%
301285.SZ	鸿日达	15.56%	688173.SH	希荻微	-5.74%

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所



### 3. 行业新闻

#### CFM 闪存市场：存储现货市场流速缓慢，供需多空激烈博弈

3月12日消息，根据CFM闪存市场报道，在存储现货市场需求放缓的市况下，本周存储行情多以持平为主，市场观望氛围浓厚，现货SSD和内存价格维持不变，嵌入式需求较为稳固本周价格小幅上扬。上半年传统淡季对市场有明显影响，由于备货需求普遍放缓，近期市场成交不活跃，基本处于按需少量进货状态，加上一季度原厂成品端价格基本已落地，季度末存储行情波动不大以横盘为主。渠道市场短期有部分抛货变现现象，近期现货市场普遍感受到卖压，但部分原厂wafer报价继续强势上扬，受资源成本上涨影响，存储价格整体依然坚挺，供需两端短期态度分化多空激烈博弈。存储行情在供需博弈下多以持平为主，少量订单需结合实际需求而定。本周NAND Flash Wafer价格持平不变，eTTDDR资源跟随实际成交价小幅调涨，少量资源价格有松动迹象，整体变动不大。

资料来源：(CFM 闪存市场)

#### TrendForce：HBM3 原由 SK 海力士独供，三星获 AMD 验证通过

3月13日消息，根据TrendForce集邦咨询报道，据TrendForce集邦咨询资深研究副总吴雅婷表示，目前2024年HBM (High Bandwidth Memory) 市场主流为HBM3，NVIDIA新世代含B100或H200的规格则为最新HBM3e产品。不过，由于AI需求高涨，目前英伟达(NVIDIA)以及其他品牌的GPU或ASIC供应紧俏，除了CoWoS是供应瓶颈，HBM亦同，主要是HBM生产周期较DDR5更长，投片到产出与封装完成需要两个季度以上所致。由于三星是AMD长期以来最重要的策略供应伙伴，2024年第一季，三星HBM3产品也陆续通过AMD MI300系列验证，其中包含其8h与12h产品，故自2024年第一季以后，三星HBM3产品将会逐渐放量。值得注意的是，过去在HBM3世代的产品竞争中，美光(Micron)始终没有加入供应行列，仅有两大韩系供应商独撑，且SK海力士HBM市占率目前为最高，三星将随着后续数个季度MI300逐季放量，市占率将急起直追。而自2024年起，市场关注焦点即由HBM3转向HBM3e，预计下半年将逐季放量，并逐步成为HBM市场主流。据TrendForce集邦咨询调查，第一季由SK海力士率先通过验证，美光紧跟其后，并于第一季底开始递交HBM3e量产产品，以搭配计划在第二季末铺货的NVIDIA H200。三星由于递交样品的时程较其他两家供应商略晚，预计其HBM3e将于第一季末前通过验证，并于第二季开始正式出货。由于三星HBM3的验证已经有了突破，且HBM3e的验证若无意外也即将完成，这也意味着该公司的出货市占于2024年末将与SK海力士拉近差距。

资料来源：(TrendForce 集邦咨询)



### **Silicon Box 计划在意投资 36 亿欧元建设先进封装产能**

3 月 13 日消息，根据 IT 之家报道，半导体创企 Silicon Box 宣布计划与意大利政府合作，在意北部投资 36 亿欧元，建设先进封测产能。

资料来源：(IT 之家)

### **AI 芯片 WSE-3 发布，一天就可以完成 Llama 700 亿参数的训练**

3 月 13 日消息，根据科创板日报报道，美国加州半导体公司 Cerebras Systems 发布第三代晶圆级 AI 加速芯片“WSE-3”(Wafer Scale Engine 3)，规格参数更加疯狂，而且在功耗、价格不变的前提下性能翻了一番。WSE-3 再次升级为台积电 5nm 工艺，面积没说但应该差不多，然而，晶体管数量继续增加达到惊人的 4 万亿个，AI 核心数量进一步增加到 90 万个，缓存容量达到 44GB，外部搭配内存容量可选 1.5TB、12TB、1200TB。核心数量、缓存容量增加的并不多，但性能实现了飞跃，峰值 AI 算力高达 125PFlops，也就是每秒 12.5 亿亿次浮点计算，堪比顶级超算。

资料来源：(科创板日报)

## 4. 公司动态

### 【宏微科技】公司 SiC 二极管产品已完成定型，部分产品已达成量产状态

3月13日消息，宏微科技在投资者互动平台表示，公司的 SiC 产品线规划全面，相关产品应用于新能源汽车主驱、车载充电系统、超级充电桩电源模块、光伏逆变系统、储能系统、轨道交通、工业电源等领域。目前，公司 SiC 自研芯片产品处于研发导入阶段，SiC 二极管产品已完成定型，部分产品已达成量产状态，SiC Mos 平台已定型，处于初步量产状态。SiC 光伏端混合封装模块出货量已突破 100 万只，SiC 车规端模块采用先进的封装工艺，正在积极配合终端客户验证中。

资料来源：（投资者互动平台）

### 【立昂微】公司图像传感器件和功率器件已实现批量出货

3月11日消息，立昂微在投资者互动平台表示，公司生产的 12 英寸半导体硅片技术能力已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，图像传感器件和功率器件覆盖客户所需技术节点且已实现批量出货。

资料来源：（投资者互动平台）

### 【龙芯中科】2K3000 计划在 2024 年上半年交付流片，LG200 正在展开全面验证

3月11日消息，龙芯中科在投资者互动平台表示，龙芯第二代 GPU 核 LG200 将在 2K3000 中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI 加速。2K3000 计划在 2024 年上半年交付流片。在此基础上，后续将基于 2K3000 的 GPGPU 技术及 3C6000 的龙链技术，研制专用 GPGPU 芯片。目前 LG200 已完成结构设计和前期的物理设计评估，配套的驱动程序原型也已就绪，正在展开全面验证。

资料来源：（投资者互动平台）

### 【炬芯科技】公司将推出高端 AI 音频芯片

3月11日消息，炬芯科技在投资者互动平台表示，公司致力于提供基于智慧物联网领域的低功耗大算力端侧 AIoT 芯片平台，满足市场未来日新月异的低功耗端侧设备的人工智能应用需求。公司的芯片产品积极推进场景化布局和发展，涵盖手机、电脑、电视等周边，目前可用于智能手表、AR 眼镜等 AIoT 智能穿戴设备中。随着各类终端产品的 AI 化进展，公司将推出高端 AI 音频芯片，将从芯片端持续满足智能终端设备 AI 性能的需求，把握智能终端产品的 AI 化趋势。

资料来源：（投资者互动平台）

### 【杰华特】公司已形成完整的 DR MOS+多相的产品矩阵

请务必阅读报告正文后各项声明

3月13日消息，杰华特在投资者互动平台表示，公司 DrMOS 和多相业务在持续推进中，其 30A~90A DrMOS 及 6 相、8 相等多相控制器均已实现量产，其中 90A 的 DrMOS 为 2023 年重点推出产品，还将推出 12 相等多款产品。目前，公司在 PC-服务器-AI-自动驾驶等应用领域已形成完整的 DRMOS+多相的产品矩阵。

资料来源：（投资者互动平台）

#### 【希荻微】公司推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用 DC-DC 芯片

3月11日消息，希荻微在投资者互动平台表示，公司以 DC/DC 芯片、超级快充芯片等为代表的主要产品，具备了与国内外龙头厂商相竞争的性能，已广泛应用于安卓链品牌客户的消费电子设备中，覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。近期，公司推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用 DC-DC 芯片，凭借其宽电压范围、高效能和智能限流方案等独特优势，以及广阔的应用前景，有望在市场上树立新的标杆，为 AI 手机等设备长续航加持。

资料来源：（投资者互动平台）

#### 【翱捷科技】公司首款 5G RedCap 芯片预计年中开始逐步量产

3月13日消息，翱捷科技在投资者互动平台表示，截至 2023 年年末，公司首款 4G 智能手机芯片的首批客户送样已经完成，处于量产前期；首款 5G RedCap 芯片尚未量产，预计 2024 年年中开始逐步量产。AI 手机芯片方面，我们已经有了相关技术储备，随着后续智能手机基带芯片的迭代和产品线的丰富，技术成果将得以落地体现。

资料来源：（投资者互动平台）

#### 【永新光学】公司目前已成为康耐视定制类光学产品第一大供应商

3月13日消息，永新光学在投资者互动平台表示，在机器视觉领域，公司与康耐视、Zebra 等行业头部企业建立了长期稳定的合作关系，目前已成为康耐视定制类光学产品第一大供应商；此外，公司积极拓展开发新产品并拓展国内外新客户，生产的机器视觉镜头已在工业检测、工业自动化、家用、商用以及智能仓储管理的移动机器人等场景均有应用。

资料来源：（投资者互动平台）

#### 【盛洋科技】公司自研的某型号终端已通过海南交信北斗相关测试，并完成小批量生产

3月12日消息，盛洋科技在投资者互动平台表示，自合作以来，公司组建了具有车载终端行业丰富经验的技术、质量和生产管理团队，在原有 ERP (SAP) 全面管理系统基础上，搭建并应用了车规质量管理体系

IATF16949-2016 和高端制造执行管理系统 MES，自研的某型号终端已通过海南交信北斗相关测试，并完成小批量生产。后续，根据市场情况和客户需求可进行新型号终端研发和批量生产。

资料来源：（投资者互动平台）

## 5. 公司公告

**表2:电子行业本周重点公告 (3.11-3.15)**

日期	公司	公告类型	要闻
2024/03/11	利亚德	回购股权	公司拟以3000万元至6000万元回购股份,将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司价值及股东权益(出售),回购价格不超过7.4元/股。按不低于人民币3,000万元(含)的回购金额下限测算,预计回购数量为4,054,054股,占公司当前总股本的0.16%;按不超过人民币6,000万元(含)的回购金额上限测算,预计回购数量为8,108,108股,占公司当前总股本的0.32%,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
2024/03/11	兆易创新	回购股权	公司通过集中竞价交易方式首次回购股份67,800股,占公司总股本的比例为0.01%,购买的最高价格为人民币74.60元/股,最低价格为人民币73.71元/股,已支付的总金额为人民币5,021,872元(不含交易费用)。
2024/03/11	冠捷科技	业绩快报	2023年归属于母公司所有者的净利润2.78亿元,同比增长220.19%;营业收入545.97亿元,同比减少11.77%;基本每股收益0.0613元,同比增长220.94%
2024/03/12	鹏鼎控股	业绩快报	2023年归属于母公司所有者的净利润32.87亿元,同比减少34.41%;营业收入320.66亿元,同比减少11.45%;基本每股收益1.42元,同比减少34.26%。
2024/03/12	捷捷微电	年度报告	2023年营业收入约21.06亿元,同比增加15.51%;归属于上市公司股东的净利润约2.19亿元,同比减少39.04%;基本每股收益0.3元,同比减少38.78%。
2024/03/12	芯朋微	回购股权	回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含),不超过人民币8,000.00万元(含);回购价格:不超过人民币53.24元/股(含)
2024/03/13	洲明科技	回购股权	本次拟以不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不超过10元/股。按最高回购价格10元/股和回购金额区间测算,预计回购股份数量为250万股至500万股,占公司目前总股本的0.23%至0.46%。
2024/03/13	富瀚微	回购股权	本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准,回购资金来源为公司自有资金。以回购价格上限49元/股,按回购金额下限测算,预计可回购股份数量为1,020,408股,占公司当前总股本的比例为0.44%;按回购金额上限测算,预计可回购股份数量为2,040,816股,占公司当前总股本的比例为0.88%
2024/03/13	领益智造	回购股权	回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币1亿元(含),回购股份的价格不超过人民币7.50元/股。按回购资金总额的上限及回购股份价格上限测算,预计回购股份数量约为13,333,333股,占公司当前总股本的0.19%;按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算,预计回购股份数量为6,666,667股,占公司当前总股本的0.10%。
2024/03/14	深南电路	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润13.98亿元,同比减少14.81%;营业收入135.26亿元,同比减少3.33%;基本每股收益2.73元,同比减少15.22%。
2024/03/14	深天马A	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润亏损20.98亿元,上年同期净利润1.12亿元,由盈转亏;营业收入322.71亿元,同比增长2.62%;基本每股收益-0.8535元,上年同期基本每股收益0.0454元。

资料来源:Wind,甬兴证券研究所

## 6. 风险提示

### 1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

### 2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

### 3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

## 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

## 公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

## 投资评级体系与评级定义

<b>股票投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
<b>行业投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

## 投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

## 特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

## 版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。



**重要声明**

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。